



# 中华人民共和国国家军用标准

FL 6100

GJB 5914-2006

---

## 各种质量等级军用半导体器件 破坏性物理分析方法

Methods of destructive physical analysis  
for military semiconductor devices of all kinds of quality class

2006-12-15 发布

2007-05-01 实施

---

国防科学技术工业委员会 发布

## 目 次

前言.....	IV
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 一般要求.....	2
4.1 抽样.....	2
4.1.1 概述.....	2
4.1.2 批质量一致性检验抽样.....	2
4.1.2.1 概述.....	2
4.1.2.2 样本大小.....	2
4.1.2.3 抽样方式.....	2
4.1.2.4 并行检验.....	2
4.1.2.5 组合样本.....	2
4.1.2.6 电特性不合格半导体器件的使用.....	2
4.1.3 关键过程(工艺)监控的抽样.....	2
4.1.4 交货检验或到货检验.....	3
4.1.5 超期复验抽样.....	3
4.1.6 重新抽样.....	3
4.2 DPA 方案.....	3
4.2.1 概述.....	3
4.2.2 DPA 样品的背景材料.....	3
4.2.3 基本结构信息.....	3
4.2.4 检验项目和方法.....	3
4.2.5 DPA 程序.....	3
4.2.6 缺陷判据.....	3
4.2.7 DPA 数据记录.....	3
4.2.8 DPA 的环境要求.....	4
4.3 DPA 项目.....	4
4.3.1 概述.....	4
4.3.2 外部目检.....	4
4.3.3 射线检查.....	4
4.3.4 显微检查.....	4
4.3.5 样品的开封和制备.....	4
4.3.5.1 概述.....	4
4.3.5.2 开封.....	4
4.3.5.3 样品剖面制备.....	4
4.3.5.4 扫描电子显微镜(SEM)检查样品的制备.....	4
4.4 DPA 结论.....	4

4.5 样品和资料保存.....	5
4.5.1 样品保存.....	5
4.5.2 资料保存.....	5
4.6 应用指南.....	5
5 详细要求.....	5
工作项目 100 集成电路.....	9
工作项目 111 A <sub>1</sub> 质量等级半导体集成电路.....	9
工作项目 112 A <sub>2</sub> 质量等级半导体集成电路.....	11
工作项目 113 A <sub>3</sub> 质量等级半导体集成电路.....	12
工作项目 114 A <sub>4</sub> 质量等级半导体集成电路.....	13
工作项目 115 B <sub>1</sub> 质量等级半导体集成电路.....	14
工作项目 116 B <sub>2</sub> 质量等级半导体集成电路.....	15
工作项目 117 C <sub>1</sub> 质量等级半导体集成电路.....	16
工作项目 118 C <sub>2</sub> 质量等级半导体集成电路.....	16
工作项目 121 A <sub>1</sub> 质量等级混合集成电路(含多芯片组件).....	17
工作项目 122 A <sub>2</sub> 质量等级混合集成电路(含多芯片组件).....	18
工作项目 123 A <sub>3</sub> 质量等级混合集成电路(含多芯片组件).....	19
工作项目 124 A <sub>4</sub> 质量等级混合集成电路(含多芯片组件).....	20
工作项目 125 B <sub>1</sub> 质量等级混合集成电路(含多芯片组件).....	21
工作项目 126 B <sub>2</sub> 质量等级混合集成电路(含多芯片组件).....	22
工作项目 127 C 质量等级混合集成电路(含多芯片组件).....	23
工作项目 131 塑封半导体集成电路.....	23
工作项目 200 半导体分立器件.....	24
工作项目 211 A <sub>1</sub> 质量等级无键合引线轴向引线玻璃外壳和玻璃钝化封装二极管.....	24
工作项目 212 A <sub>2</sub> 质量等级无键合引线轴向引线玻璃外壳和玻璃钝化封装二极管.....	25
工作项目 213 A <sub>3</sub> 质量等级无键合引线轴向引线玻璃外壳和玻璃钝化封装二极管.....	26
工作项目 214 A <sub>4</sub> 质量等级无键合引线轴向引线玻璃外壳和玻璃钝化封装二极管.....	26
工作项目 215 B <sub>1</sub> 质量等级无键合引线轴向引线玻璃外壳和玻璃钝化封装二极管.....	27
工作项目 216 B <sub>2</sub> 质量等级无键合引线轴向引线玻璃外壳和玻璃钝化封装二极管.....	27
工作项目 217 C 质量等级无键合引线轴向引线玻璃外壳和玻璃钝化封装二极管.....	27
工作项目 221 A <sub>1</sub> 质量等级无键合引线螺栓安装和轴向引线金属外壳二极管.....	28
工作项目 222 A <sub>2</sub> 质量等级无键合引线螺栓安装和轴向引线金属外壳二极管.....	29
工作项目 223 A <sub>3</sub> 质量等级无键合引线螺栓安装和轴向引线金属外壳二极管.....	30
工作项目 224 A <sub>4</sub> 质量等级无键合引线螺栓安装和轴向引线金属外壳二极管.....	31
工作项目 225 B <sub>1</sub> 质量等级无键合引线螺栓安装和轴向引线金属外壳二极管.....	32
工作项目 226 B <sub>2</sub> 质量等级无键合引线螺栓安装和轴向引线金属外壳二极管.....	32
工作项目 227 C 质量等级无键合引线螺栓安装和轴向引线金属外壳二极管.....	33
工作项目 231 A <sub>1</sub> 质量等级表面安装和外引线同向引出晶体管、二极管.....	33
工作项目 232 A <sub>2</sub> 质量等级表面安装和外引线同向引出晶体管、二极管.....	34
工作项目 233 A <sub>3</sub> 质量等级表面安装和外引线同向引出晶体管、二极管.....	35
工作项目 234 A <sub>4</sub> 质量等级表面安装和外引线同向引出晶体管、二极管.....	37
工作项目 235 B <sub>1</sub> 质量等级表面安装和外引线同向引出晶体管、二极管.....	37
工作项目 236 B <sub>2</sub> 质量等级表面安装和外引线同向引出晶体管、二极管.....	38